



行业动态  
Industry News



### 华邦选用惠瑞捷V5400系统测试闪存晶圆

2009-01-06 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

惠瑞捷(Verigy)公司宣布,内存供货商华邦电子(Winbond Electronics)已采购多套VerigyV5400闪存测试系统,供台中厂使用,以测试SpiFlash序列式闪存的晶圆。这些内存采用序列外围接口(SPI),广泛使用于PC、移动电话和其它移动装置中。

V5000系列内存测试系统是一套完整的解决方案,从工程开发到大量生产,可解决所有的内存测试需求。V5000系列采用可扩充的机台架构,并将测试系统的资源做最佳化的利用,因此,能有效率地测试所有的内存类型,有效解决各式各样的内存测试问题。

可程式化接口矩阵技术可提供极高的接脚数(24,576只接脚)、最强的平行测试能力(x512NAND、x512NOR、x576SPI和x384MCP)、以及最高的测试系统利用率,如针对闪存的晶圆测试提供多达4608个I/O信道,且每套系统可以做弹性的配置,最多可测试144个组件。因此,相比于传统的闪存测试系统,可以大幅降低测试成本。

V5000系列采用第五代的Tester-per-Site架构,可以让客户完整地移转测试程序且能保持原有的稳定性,从设计、晶圆到终程等不同的测试阶段,都能以超高的效率移转测试程序。

华邦电子选择V5400的原因在于该闪存测试系统的成本低于其它系统,且V5400测试系统在台湾安装的数量相当庞大,更容易提供客户需要的服务。

华邦电子原本已经采用惠瑞捷V5000系列旗下的V5000e工程开发工作站,现在,只要将既有的测试程序移转到V5400系统上,即可执行量产测试,效率超高。

(来源:国际电子商情 2008年12月23日)

科普首页

微电子历史

行业动态

术语解释

无微不至

芯片制程

科普创意